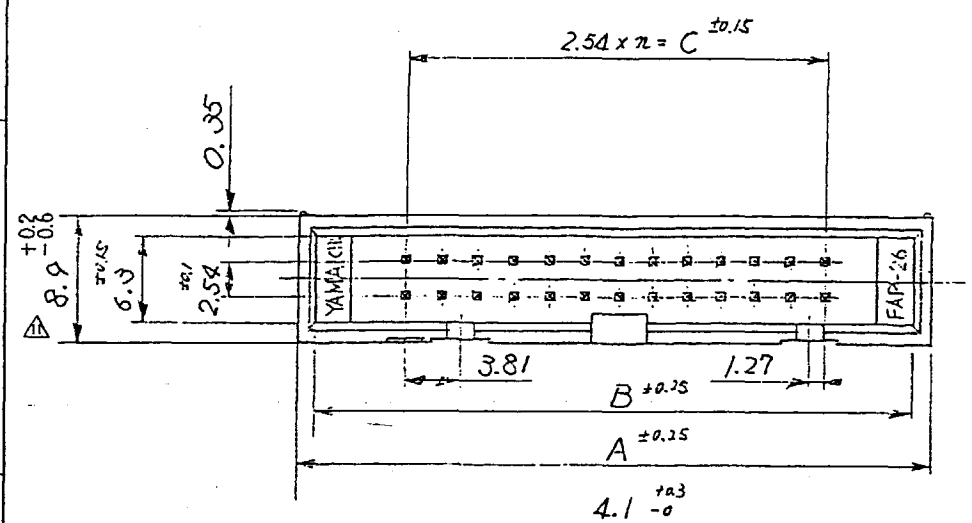
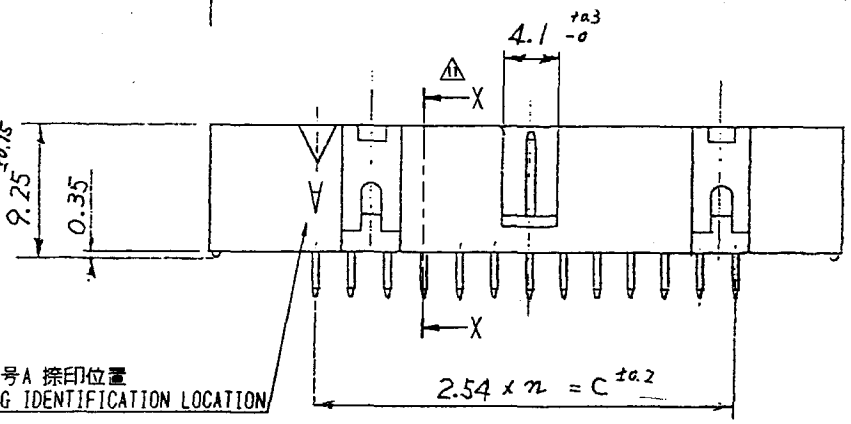
DRW. NO. KL-6027 | Sheet No. /

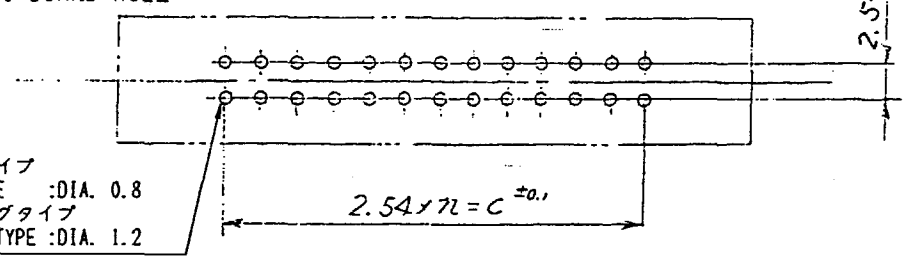
記号×数	変更内容 REVISION DESCRIPTION	承認	担当	年・月・日	変更通知書番号
⚠ × 3	芯数追加	——	豊田	'88・10・7	89-1488
⚠ × 4	名称及び仕上げ変更	——	豊田	'89・1・20	89-0076
⚠ × 3	めっき仕様変更(部分めっき仕様追加)及び名称、分解図番号変更	——	湯澤	'90・6・11	技90-1262
⚠ × 6	英文併記、公差変更、指定外寸法公差追加、A捺印位置指示	伊東	松本	'97・6・12	技97-4168





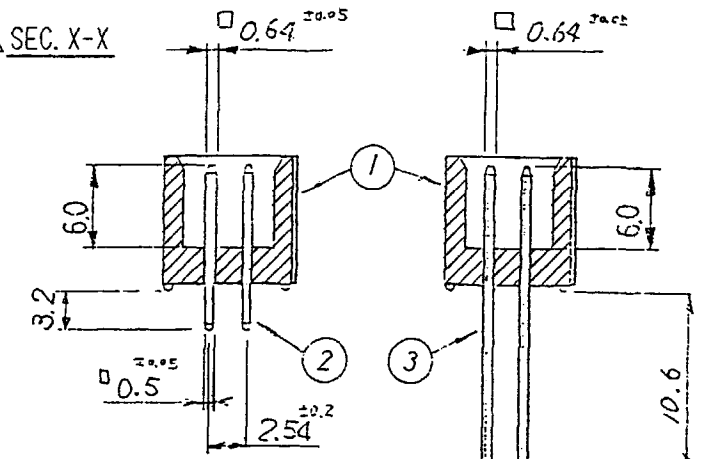
⚠ 追加記号A 捺印位置
PLATING IDENTIFICATION LOCATION

プリント基板穴あけ寸法
P.C BOARD HOLE



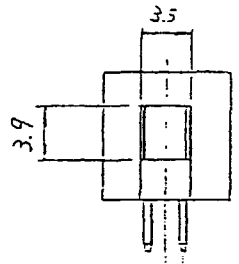
半田ディップタイプ
SOLDER DIP TYPE :DIA. 0.8
ワイヤラッピングタイプ
WIRE WRAPPING TYPE :DIA. 1.2

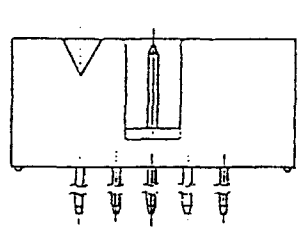
⚠ SEC. X-X



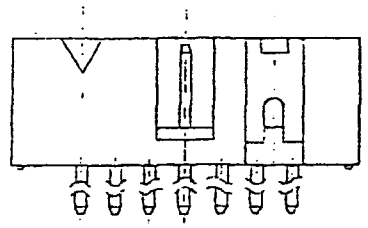
FAP-**-08#4
半田ディップタイプ
SOLDER DIP TYPE

FAP-**-08#3
ワイヤラッピングタイプ
WIRE WRAPPING TYPE





FAP-10-08
10芯のみ両側の溝無し
FAP-10-08 is available without side slot only.
(Refer to above shape)



FAP-14-08
14芯のみ上図形状とする。
FAP-10-08 is available with one side slot only.
(Refer to above shape)

めっき仕様 PLATING GRADE

1. 標準めっき仕様 PLATING SPECIFICATIONS
   下地めっき BASE PLATING : Ni 2.5～4.5micro-m.
   接触部めっき CONTACT AREA : Au 0.3micro-m. MIN.
   端子部めっき TERMINAL AREA : SnPb 2.0～4.0micro-m
2. 上記以外のめっき仕様については仕様書(KS-5253)による。
   但し、接触部"A"級の場合には図中指示部にA記号を捺印する。
   Ordering cord for special plating version are identified on the drawing No. KS-5253.
   "A" marking shall be indicated on the body shown as the sketch.

性能 SPECIFICATION

1. 絶縁抵抗 : DC500Vにて1000MΩ以上
   INSULATION RESISTANCE : 1000M ohm. MIN. at 500V DC.
2. 耐電圧 : AC700Vを1分間印加し異常無いこと。
   DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : For 1 minute at 700V AC.
3. コンタクト保持力 : 断面図(SEC. X-X)の状態でコンタクトを押し下げて2.3kgf(22.5N)以上。
   CONTACT RETENTION FORCE : In case of the operation of pushing contact from avobe on X-X sectional drawing MIN. 2.3kgf(22.5N).
4. その他 : その他の性能はMIL-STD-202E等に準じて試験を行う。
   OTHERS : Tested complied with MIL-STD-202E and so on.

FAP-**-08 #3 #4	芯数 No. OF CONTACTS	A	B	C	n
FAP-64-08	64	88.90	86.50	78.74	31
FAP-60-08	60	83.80	81.40	73.66	29
FAP-50-08	50	71.10	68.70	60.96	24
FAP-40-08	40	58.40	56.00	48.26	19
FAP-34-08	34	50.80	48.40	40.64	16
FAP-30-08	30	45.70	43.30	35.56	14
FAP-26-08	26	40.60	38.20	30.48	12
FAP-20-08	20	33.00	30.60	22.86	9
FAP-16-08	16	27.90	25.50	17.78	7
FAP-14-08	14	25.40	23.00	15.24	6
FAP-10-08	10	20.30	17.90	10.16	4
製品名称 PART No.					

FAP-**-08 #3 #4 (-1)	黒(BLACK)	FAP-**-08絶縁基板(-1) INSULATOR(-1)
FAP-**-08 #3 #4 -2	青(BLUE)	FAP-**-08絶縁基板-2 INSULATOR-2
製品名称 PART No.	仕上色 COLOR	絶縁基板 INSULATOR

⚠	部品番号 ITEM	部品名 DESCRIPTION	個数 QNT.	材質・寸度 MATERIAL	記事 CONTENT	分解図番号 PART IDENT
	3	CONTACT 226	N	PB t0.64	REFER TO PLATING SPEC	SL-7809
	2	CONTACT 185	N	CuNiZn t0.64	REFER TO PLATING SPEC	SL-13515
	1	FAP-**-08絶縁基板 INSULATOR	1	PBT (GF)	UL94V-0	SL-7591

⚠ 指定外寸法公差 ±0.3
TOLERANCES ±0.3 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

尺度 SCALE	2/1	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
単位 DIMENSION	mm	'97・6・12	'97・6・12	'97・6・12	'97・6・12	'81・6・22
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION		伊東	松田	茂木	松本	青本

分類 (CLASS) FLEXICON
名称 (TITLE) FAP-**-08 #3 #4 -*-***
図番 (DRW. NO.) KL-6027
Sheet No. /
REV. M

COPY MAR 01 2000

YEUIS00088

A3-ED005-95-09